

김영호(공과대학)

김영호는 [한양대학교 서울캠퍼스 공과대학 신소재공학부](#) 교수이자 [마이크로패키징 및 나노소재 연구실](#)장을 겸하고 있다.

- 연락처: 02-2220-0405 / kimyh@hanyang.ac.kr
- 홈페이지: <http://packaging.hanyang.ac.kr>

□

목차

- [1 학력](#)
- [2 경력](#)
- [3 학회활동](#)
- [4 수상](#)
- [5 담당과목](#)
- [6 동정](#)

학력

- 1985, UC Berkeley 대학교 재료공학 공학박사
- 1980, 서울대학교 금속공학 공학석사
- 1978, 서울대학교 금속공학 공학사

경력

- 1991.3 ~ 현재 한양대학교 신소재공학부, 교수
- 2000.2 ~ 2002.2 U.C. Berkeley, 방문교수
- 1992.7 ~ 1992.8 Oxford 대학교, 방문교수
- 1987.8 ~ 1991.3 한국과학기술연구원(KIST), 연구원
- 1985.6 ~ 1987.7 IBM T.J. Watson 연구소, 연구원
- 1985.1 ~ 1985.6 미국 Lawrence Berkeley Lab., 연구원

학회활동

- 1985-1987 IBM T. J. Watson Research Center 연구원
- 1985-1991 한국과학기술연구원 선임연구원
- 1991-현재 한양대학교 신소재공학부 교수

- 1999-2001 대학산업기술지원단 부단장
- 2000-2002 U. C. Berkeley 방문 교수
- 2003-2008 한국마이크로전자 및 패키징 학회 (IMAPS Korea) 부회장
- 2005-2007 대한금속재료학회, 편집이사
- 2007-2008 한국마이크로전자 및 패키징 학회 (IMAPS Korea) 회장
- 2009-현재 한국마이크로전자 및 패키징 학회 (IMAPS Korea) 명예회장
- 2010-2014 한양대학교 디스플레이공학연구소 소장
- 2014-현재 한국공학한림원, 정회원
- 2017-2018 Electronic Materials Letters, Editor-in chief

수상

- 2009 한국마이크로전자 및 패키징학회/해동과학문화재단 해동학술상
- 2011 대한금속재료학회 POSCO 학술상
- 2013 EMAP General Chair

담당과목

- 학부: 재료과학 1,2, 반도체공정
- 대학원: 전자패키징, 전자재료세미나

동정

- 2019년 3월 일진머티리얼즈 사외이사 재선임